

今年も世界を代表する製造装置メーカーが集結します!!

半導体製造装置基礎 後工程

1章

パッケージング技術概要+ボンダ概論



ヤマハロボティクスホールディングス株式会社 小坂 浩之 様

2章

モールドング装置概論



TOWA株式会社 白澤 賢典 様



一般社団法人 日本半導体製造装置協会(SEAJ)

半導体デバイス製造に携わる後工程エンジニア(アセンブリ・パッケージ・テスト)を対象に、主要な後工程の製造装置について基礎から学びます。各半導体後工程の製造装置メーカーの専門家が、各工程で求められる技術要素(メカ、エレキ、ソフト、材料・プロセス)の概要を紹介するとともに、装置および実装・パッケージング・テスト技術の詳細を解説します。本講座は(一社)日本半導体製造装置協会(SEAJ)会員企業によるコラボレーション講座です。

3章

テスト概論



株式会社アドバンテスト 石田 雅裕 様

2026年2月17日(火) 13:00~16:30

お申し込み期間は 2025年11月27日(木)9:00から2026年2月12日(木)17:00までとなります。

受講料 特別提供 **3,300円(税込)**

定員: 対面受講50名 / オンライン200名



●対面受講会場
福岡システムLSI総合開発センター
2F 講義室
住所 福岡市早良区百道浜3-8-33

●オンライン受講会場 Zoom
(接続先リンクはお支払い完了後にご案内)



●お申込み方法
ふくおかIST e-learningのホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体製造装置基礎」の「対面受講申込」または「オンライン(OL)受講申込」を選択ください。

ふくおかIST e-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail: reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター 事務局

■ お申込みに、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です。 ■ お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。 ■ 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。 ■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。 ■ 対面受講の方は、会場にて紙テキストを配布します。PDFテキスト(コピー・印刷不可、コメント追加可)のダウンロードも可能です。 ※テキストの無断転載・複製等は禁止しています。



福岡県内
中小企業の方は
※消費税及び地方消費税を除く

受講料全額補助



公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター



補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体
リスキリングセンターのホーム
ページから、申請要領・交付
要綱をご確認ください。

